

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2023-0213-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	博道基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、普徠仕香港有限公司、华福证券有限责任公司、路博迈投资管理（上海）有限公司
时间	2023年2月13日 10:30-11:30
地点	公司会议室
公司接待人员	证券事务代表：钱元君
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、介绍了公司2022年业绩情况</p> <p>2022年Q4随着供应链短缺和资源限制等因素的改善，企业通讯市场板市场客户提货相对加速，2022年Q4公司实现营业收入约25.72亿，环比增长约26.85%，同比增长约28.17%。从全年看，受益于交换机、路由器、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板（下称“PCB”）的结构性需求以及汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，对ADAS(高级驾驶辅助系统)、智能座舱、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域中高端PCB的持续需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，公司PCB业务实现营业收入约79.31亿元，比去年同期增长约12.36%；同时随着公司PCB业务产品结构的进一步优化，公司PCB业务毛利率提升至约31.72%，较上年同期增加约3.22个百分点。</p> <p style="text-align: center;">二、介绍了企业通讯市场板业务情况</p> <p>企业通讯市场板业务占公司PCB营收70%左右。2022年下半年，终端积压的需求随着供应链短缺和资源限制等因素的陆续改善，其订单得以执行，促使客户开始缩减先前因恐慌而重复下单的库存，公司先前订单形成的存货，随着客户去库</p>

存，陆续提货，也逐步得到消化。受客户去库存、全球经济不确定性加剧了对市场需求水平的可持续性的担忧等因素影响，短期看企业通讯市场板新增订单预期将有所下滑，但中长期的需求趋势不会改变。如果经济环境不确定性提高，短期订单波动也可能会明显变大。

从中长期看云计算、大数据、超高清视频、人工智能、5G行业应用等领域的发展仍将促使全球数字化转型，而疫情进一步放大了网络的重要性，加速了数字化转型的动作，推升数据中心朝高速数据传输标准发展，以强化数据中心基础设施的运算、网络、储存及安全管理的处理效能。这将加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品也有望高速增长。

比如近期不断升温的AIGC，同样离不开对于数据和算力的需求，离不开高性能的硬件及网络设备基础设施的支持。调研机构Dell'Oro Group 2月发布最新的Ethernet Switch – Data Center 5-Year January 2023 Forecast Report，预测以太网交换机数据中心市场预计在2022年至2027年期间将以近两位数的年复合增长率增长，在未来五年内累计支出将超过1000亿美元，预测到2027年，400Gbps和更高速度的数据中心交换机销售额的近70%，人工智能任务的激增将进一步加速其部署。

新一代服务器平台用PCB公司已具备批量生产能力，较上一代平台产品相比，PCB在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面均有提升，产品批量生产规模取决于平台切换情况。

三、介绍了汽车板业务情况

汽车板是公司重点业务之一，占公司PCB营收25%左右。随着受疫情影响的供应链恢复、后续市场需求的好转、产品结构的优化以及材料价格总体呈下降趋势，公司汽车板业务盈利能力也逐步得到恢复和改善。公司目前主要向Tier1类汽车电子厂商提供产品，亦有部分产品直接供给终端新能源汽车品牌厂商。汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子在整车制造成本中的占比不断提高，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志。

在汽车电子领域，公司与客户在新能源车三电系统，自动驾驶，智能座舱，车联网等方面深度合作，开展关键技术的研发，深度参与客户前期设计及验证，并投入更多资源用于汽车高阶HDI及Anylayer技术的可靠性评估和研发，紧跟汽车

行业的发展趋势，提升技术能力和适用性，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作，夯实在ADAS(高级驾驶辅助系统)、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域高端PCB的竞争优势，逐步调整优化产品和产能结构，并根据市场情况，有针对性的进行适度扩产。在具体产品方面，应用于4D车载雷达，自动驾驶域控制器，智能座舱域控制器，车载网关等领域的产品已实现量产。

为满足公司沪利微电应用于汽车电子领域的印制电路板业务中长期经营发展的资金需要，2023年初公司使用自有资金向沪利微电增资77,613.078万元人民币。

此外，出于对混合动力、纯电动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展趋势以及p2Pack技术前景的判断，经公司董事会战略委员会提议，2022年12月22日公司与Schweizer、胜伟策签署《股权转让协议》。交易如经批准完成，胜伟策将成为公司的控股子公司，为公司进一步拓展该领域汽车用PCB业务夯实基础。

四、介绍了公司生产布局情况

公司持续整合生产和管理资源，将青淞厂22层以下PCB产品以及沪利微电中低阶汽车板产品加速向黄石厂转移，以应对价格竞争；并对青淞厂、沪利微电相关瓶颈及关键制程进行更新升级和针对性扩充，以应对产品升级和新兴市场需求。

另一方面增加海外生产基地布局，以更好地开拓和应对海外市场的需求，公司已购买位于泰国洛加纳大城工业园区内的面积约201,846.8平方米的土地，以满足公司泰国子公司未来项目建设需求。公司初步计划分阶段实施建设泰国子公司，其中厂房分两期投入，生产设备分三期投入，2023年开始投入基建，并期望于2025年上半年实现一定规模的量产。

注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单

无

日期

2023年2月13日